

Title (en)

Method and apparatuses for renovating a floor

Title (de)

Verfahren und Vorrichtungen zur Sanierung eines Bodens

Title (fr)

Procédé et dispositifs pour la réhabilitation d'un sol

Publication

EP 1154100 A1 20011114 (FR)

Application

EP 01401195 A 20010510

Priority

FR 0005928 A 20000510

Abstract (en)

The reinforcing procedure involves injecting a bonding or sealing substance (15) into the mortar (12) through a series of hollow perforated steel dowels (1) to form reinforced micro-piles. The dowels have a diameter of 6 - 8 mm, inserted at intervals of 20 - 30 cm, and the fluid is injected through them at a pressure of 2 - 5 bars to form mini-piles that are virtually in contact and fill 30 - 40 per cent of the mortar layer.

Abstract (fr)

L'invention concerne la réhabilitation d'un sol constitué d'un revêtement collé ou scellé sur une chape (12) en mortier hydraulique durci réalisée sur un subjectile (13). On ancre dans le subjectile (13) des chevilles tubulaires rigides et creuses (1,2) perforées latéralement qui traversent la chape (12) présente entre le revêtement (10A,10B) et le subjectile (13) et on injecte au moyen de ces chevilles (1,2), un produit de collage ou de scellement (15) introduit sous pression dans les chevilles (1,2) pour remplir les vides présents dans la chape (12) et durcir en constituant des micropieux armés par les chevilles (1,2). Application à tout type de revêtement sur tout type de subjectile (13). <IMAGE>

IPC 1-7

E04G 23/02

IPC 8 full level

E04G 23/02 (2006.01)

CPC (source: EP)

E04G 23/0203 (2013.01); **E04G 23/0285** (2013.01)

Citation (search report)

- [A] EP 0299121 A1 19890118 - YAMAZOE TOYOHISA
- [A] WO 8701153 A1 19870226 - JANG JONG GEUN [JP]
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 06 30 April 1998 (1998-04-30)

Cited by

CN105952173A

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR

DOCDB simple family (publication)

EP 1154100 A1 20011114; FR 2808827 A1 20011116; FR 2808827 B1 20050513

DOCDB simple family (application)

EP 01401195 A 20010510; FR 0005928 A 20000510